


製品情報

IBM BladeCenter TELCO

製品概要 | 特長&メリット | 製品仕様



 [製品カタログを見る](#)
(177KB)

 [Adobe® Reader®が必要](#)

IBM BladeCenter® TはNEBS-3-/ETSIに準拠し、通信業界の最も厳格な標準規格やテスト基準を満たす豊富な機能を装備しています。VoIP、IPTV、IMSなどの、通信サービスおよび制御プレーンのアプリケーションに最適です。

ハイライト

- 総所有コスト(TCO)を削減するとともに、通信プロバイダーおよびサービス・プロバイダー業界のお客様の新たな収益チャンスの増大に寄与するよう設計された、プラットフォームです。
- 画期的なモジュール設計により音声、データ、マルチメディアを統合するIPベースの次世代ネットワーク・アプリケーション・インフラストラクチャーのサポートを可能にする信頼性、柔軟性、およびパフォーマンス密度を提供します。
- サーバー、I/O、ストレージ、オペレーティング・システム、およびアプリケーションをオートノミック機能の配備に最適な単一のコンパクトなネットワーク・プラットフォームに統合。オンデマンド・オペレーティング環境を実現します。

IBM BladeCenter Tには、奥行き20インチのシャーシ内に、統合されたサーバー、ストレージ、およびネットワークング、耐障害性機能、オプションのAC(またはDC)ホットスワップ対応冗長電源および冷却装置、さらにはシステム管理リソース(内蔵)などの豊富な通信機能が装備されています。

製品の特徴

- 高いパフォーマンス密度が、お客様のデータ・センターにおいて可能な限りのコンピューティング能力を集中させるのに役立ちます。
- IBM Directorが提供する事前対応型のシステム管理機能によって、堅固な信頼性が実現します。
- Calibrated Vectored Cooling™ (最適化された冷却機能)が内部コンポーネントを低温に保つため、システムの正常な稼働状態を維持できます。
- Light-Path診断によってトラブルシューティングが容易になるため、アップタイムを増やし、サービス・コストを削減できます。
- 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービスにより、長期間にわたる運用継続性とネットワークング・テクノロジーの使用を確保できます。

ハードウェア概要

- 8Uシャーシ
- 8個のサーバー・ベイを装備
- 最大4基のスイッチ・モジュールベイを装備
- NEBS-3-/ETSIに準拠し、通信業界の最も厳格な標準規格やテスト基準を満たす豊富な機能
- 負荷分散機能とフェイルオーバー機能を備えた最大4基の1300Wホットスワップ対応冗長電源

[↑ 上に戻る](#)

- 1 このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。
- 2 画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。
- 3 このカタログの情報は2007年1月24日現在のものです。
- 4 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。
- 5 当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

- IBM、ServerGuide、ServeRAID、Chipkill、xSeriesは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標。
Microsoft、Windows、Windows NTおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Xeonは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標。
Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標。
他の会社名、製品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。

製品情報

IBM BladeCenter TELCO

製品概要 | 特長&メリット | 製品仕様

- ↓ [IBM BladeCenter® HS20\(8843-JTJ/MTJ\)](#)
- ↓ [IBM BladeCenter T \(8720-2RJ、8730-2RJ\)](#)

製品仕様

モデル		BladeCenter HS20	
		8843-JTJ	8843-MTJ
発表日		2006/2/14	2006/2/14
Bladeベイ・スペース		1	
プロセッサ	搭載CPU数	1(最大2)	
	タイプ	64ビット インテル® Xeon® プロセッサ低電圧版	
	2次キャッシュ	1MB(フルスピード)	2MB(フルスピード)
	3次キャッシュ	-	
	動作周波数	2.80GHz	3GHz
	フロント・サイド・バス	800MHz(200MHz QP)	
	SMPアップグレード※1	2.80GHz(2Way)	3GHz(2Way)
チップ・セット		Intel E7520(Chipkill機能付き)	
主記憶(PC2-3200対応 DDR2 SDRAM)	標準容量	1GB ECC RDIMM non Chipkill※2	
	DIMM装着状況	2 x 512MB	
	DIMMソケット数(空き)	4(2)	
	最大容量	16GB※3	
ビデオ・サブシステム		SVGA(ATI Mobility Radeon)	
ビデオ・メモリー		16MB	
ディスク・インターフェイス	タイプ	Ultra320 SCSI(オンボード RAID 1機能付き)	
	チャンネル数	1	
	内部コネクタ	2	
	外部コネクタ	0	
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量※4	146.8GB※5	
	HDDベイ(空き)	2(2)	
ストレージ拡張装置 オプション	Bladeベイ・スペース	1	
	P/N	26K4817	
	タイプ	Ultra320 SCSI(RAID機能付き※6)	
	チャンネル数	1	
	内部コネクタ	1	
	外部コネクタ	0	

	標準HDD容量	オープン
	最大HDD容量 ※4	600GB※7
	ホットスワップバ イ(空き)	2(2)
ファイバーチャネル・カード		オプション
ネットワーク・インターフェース		2x 全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5704S)
システム管理機能		標準装備
環境対応		RoHS指令※8準拠
エネルギー消費効率※9		掲載対象外
サポートOS※10 ・最新サポート情報はこちら Windows Linux		Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition、Windows Server™ 2003 Standard Edition (32bit)、Windows Server™ 2003 Standard Edition (32bit)、Windows Server™ 2003 Web Edition (32bit)、Microsoft® Windows® 2000 Server (SP4)、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server (SP4)、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for x86※10、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 4 for AMD64 and EM64T※10、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for x86※10、Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WS 3 for AMD64 and EM64T※10、Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 for x86 (Update6 + Latest Kernel 2.4.9-e.65以降)※10、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD & EM64T※10、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for x86※10、VMware® ESX Server 2.5
付属品		インストール・ガイド、ドキュメントCDパック
サービス		スタートアップ 90 無償キャンペーン適用対象※13
保証	国内での保証	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(8時間×週5日CRU※14)
	海外での保証	あり: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

- ※1 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。
- ※2 Chipkill機能非対応。
- ※3 4GBメモリーを4つ装着した場合。(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。またBladeCenterの電源モジュールを1800W以上に換装する必要があります。)
- ※4 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。
- ※5 73.4GBの2.5型SCSIハードディスクを2台装着した場合。
- ※6 この拡張ユニットに装着するハード・ディスクは、標準SCSIコントローラに接続され、内蔵のHDDと併せて、RAID1、1Eを含む、最大4つのハード・ディスクから成るRAIDを構築できるようになります。ただし、システム全体で構築できるアレイの数は1つだけです。また、既存のRAID構成の変更には再構築が必要です。
- ※7 300GBのSCSIホットスワップ・スリム・ハードディスクを2台装着した場合。
- ※8 特定有害物質の使用制限に関するEUの指令。対象物質は鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニールエーテルで、この6物質の使用について制限されます。
- ※9 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※10 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。
- ※11 基本OS部分のみ。
- ※12 年額。サービス内容: 月曜日～土曜日 08:00～20:00修理対応(祝日、12月30日～1月3日、6月17日を除く)。
- ※13 詳しくは下記URLをご参照ください。

<http://www.ibm.com/jp/servers/eserver/xseries/ss90/>

- ※14 xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU (CRU=Customer Replaceable Unit, 以下CRU/お客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果、問題のある部分が一箇所に特定できその部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません)
8時間×週5日…月曜日～金曜日 09:00～17:00(祝日、12月30日～1月3日、6月17日を除く)。

↑ [上に戻る](#)

製品仕様

モデル	BladeCenter T	
	8720-2RJ	8730-2RJ
発表日	2006/2/14	2006/2/14
タイプ	ラック型(8U)※1	
ホットプラグ・Bladeベイ(空き)	8(8)	
I/Oモジュール・ベイ(空き)	4(4)	
マネージメント・モジュール・ベイ(空き)	2(1)	
メディア・トレイ(フロント)	DVD-ROM/CD-RW (24倍速)、USB1.1×2	
LAN モジュール(リア)	システム管理ポート(RJ45)×2、DSUB 15P alarm コネクター×1	
KVM モジュール(リア)	キーボード、マウス、モニター	
本体寸法(mm)	441.9(W)×556.0(D)×349.5(H)	
質量(kg)	44.5(最小構成)、87.38(最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)	2/4※2(1300W DCリダンダント)(-48 to -60 V DC)(オートリスタート機能付※3)	2/4※2(1300W ACリダンダント)(オートリスタート機能付※3)
発熱量(最大構成 / 出荷構成)	3291W(11229 Btu/Hr) / 197W(673 Btu/Hr)	3060W(10440 Btu/Hr) / 197W(673 Btu/Hr)
入力電力量(最大/最小)	3.3kVA / 0.2kVA	3.1kVA / 0.2kVA
消費電力(最大/標準)	3291W / 197W	3060W / 197W
環境対応	RoHS指令※4準拠	
添付ソフトウェア	-	
付属品	電源コード(IEC320 C14×2)(8730のみ)、フィルター・パネル×7、インストール・ガイド、ドキュメントCDパック	
保証期間	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日)	

※1 1U=約4.44センチ。

※2 BladeCenter Tのブレイドベイ5～8にHS20/HS40を導入した場合および、スイッチモジュール・ベイ3～4にモジュールを導入した場合、電源機構ベイ3およびベイ4に1300W電源モジュール(8720は90P3742、8730は90P3743)を追加してください。

※3 電源障害(停電等)からの復電時にサーバーが自動再始動する機能。

※4 特定有害物質の使用制限に関するEUの指令。

対象物質は鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルで、この6物質の使用について制限されます。

※5 xSeriesの構成部品の一部は、お客様にて交換できるように設計されており、このような考えに基づいて設計された部品をCRU (CRU=Customer Replaceable Unit, 以下CRU/お客様による交換可能部品)と呼びます。ハードウェア障害の

場合、IBMハードウェア障害テクニカルセンターにご連絡をいただき故障内容などを確認させていただき、その電話での問題判別の結果、問題のある部分が一箇所に特定できその部品がCRUの場合、IBMはお客様に交換用のCRUを送付し、お客様ご自身で交換していただきます。(IBM技術員はお客様サイトへ訪問いたしません)

24時間×週7日…月曜日～日曜日 00:00～24:00。

[↑ 上に戻る](#)

- 1 このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。
- 2 画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。
- 3 このカタログの情報は2006年4月19日現在のものです。
- 4 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。
- 5 当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

- IBM、ServerGuide、ServeRAID、Chipkill、xSeriesは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標。
- Microsoft、Windows、Windows NTおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
- Intel、Xeonは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標。
- Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標。
- 他の会社名、製品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。